完全DIY (从流程1开始) 适用 XDrive H1.1 REIN Lab (知驭实验室) QQ群:857046846 购买独立主板 (从流程4开始) 适用 XDriveBL F1.1 IVES Lab (艾维斯实验室) QQ群:557214000 购买完整套装(从流程8开始) 适用 XDriveAPP F1.1.5 3. 焊接电路版 XDrive探索流程 1. 制作PCB 2. 购买元器件 使用GERBER文件 根据BOM文件 根据焊接图 去喜欢的板厂做板子 去喜欢的平台购买物料 用喜欢的方式展示元器件位置 文件目录: (Hardware) 文件目录: (Hardware) 文件目录: (Hardware) XDrive_gerber.rar XDrive_welding_top.pdf XDrive_welding_bottom.pdf XDrive_bom.xlsx *PS: 根据反馈,由于相同 *PS: IVES & REIN 店铺即将 文件部分板厂会审核不通过, *PS: 建议打印出来摆边上 上架相关元器件以及周边 向板厂反馈是开源文件即可 5. 安装PCB 安装磁铁 使用结构胶 将磁铁安装在步进电机尾端 PCB传感器与电机轴同心 根据PCB 线圈焊盘定义 将电机线焊接在PCB上 传感器表面磁场强度<1000mT 磁铁需使用径向磁铁 *PS: 若后续发现电机旋转方向与需要的相反 传感器与磁铁尽量靠近 可以调换(A+ A-)或调换(B+ B-)修改方向 磁铁需要与电机轴同心 常规安装间隙为1mm~2.5mm 或在软件里面更改方向 *PS: 套装胶水是 ergo1309 7. 烧写引导 8. 编译APF 使用全新XDrive APP工程 仅使用USB将PCB连接电脑和XDrive 将"xdrive bl F1.2.bin"通过SWD接口 烧写到单片机Flash (0x08000000) 编译生成"xdrive_app.bin" OLED显示"XDriveBL f12" 等待电脑成功驱动在设备和驱动 文件目录: (Firmware_BL) 显示"XDriveBLf12"盘 xdrive_bl.bin 将"xdrive_app.bin"拖入 等待完成APP的更新 OLED开始显示"XDrive"软件界面 完成APP烧写 *PS: APP也可以直接使用SWD烧入 12. 首次校准 11. 正常启动 10. UI逻辑 界面逻辑文件 仅使用PH2.0接口电源启动XDrive 进入校准界面 Specification/UI Loogic.png 键入"确定"启动校准 启动过程不要按下按键 按键逻辑文件 电机会正反旋转校准 校准结果在OLED上显示 Specification/Button.png 13. 重新上电 14. 模式测试 15. 定制APP 仅使用PH2.0接口电源启动XDrive 根据使用需求修改APP程序配置 在XDrive支持的模式中选择测试 重新编译生成 "xdrive_app.bin" 根据模式调整跳线帽 1. 断开XDrive所有接线 在PH2.0输入接口传入对应信号 2. 按下UP按键 XDrive 会不停优化以实现更多功能 *PS: 在内测时 3.使用USB连接电脑和XDrive 欢迎开发者加入 发现部分无动作响应由跳线帽造成 将更新的"xdrive_app.bin' 联系方式: 联系上述群主 拖入XDriveBL f12 17. 正常使用 - 恭喜完成所有流程啦!!! 仅使用PH2.0接口电源启动XDrive

启动完成后将以定制的固件配置运行